



Information

半導体のウェハ接合技術の研究開発事業譲渡について

2025 年 10 月 31 日

株式会社ニコンは、ニコンが保有する半導体のウェハ接合技術の研究開発事業について、以下のとおり、株式会社 SCREEN ホールディングス (SCREEN) と譲渡契約を締結しましたのでお知らせします。

譲渡の背景

半導体の高性能化技術の一つとして注目されているウェハ接合について、SCREEN と当社との間で今後の協業について検討を重ねてきました。その結果、同技術を SCREEN に譲渡することが最善と判断し、この度の契約締結に至っています。引き続き SCREEN との協業体制を強化しながら、同技術の深化や実際の半導体製造への早期実装を狙います。

譲渡内容

ニコンが保有する半導体のウェハ接合技術やノウハウ、知的財産等

譲渡先の概要

社名	株式会社 SCREEN ホールディングス
所在地	京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町 1 番地の 1
代表者	代表取締役 取締役社長 後藤 正人
資本金	540 億円 (2025 年 3 月期)
設立年月日	1943 年 10 月 11 日